

龍華科技大學 函

地址：333326桃園市龜山區萬壽路一段300號

聯絡人：張勤煜

電子信箱：cyc@gm.lhu.edu.tw

聯絡電話：(02)82093211

傳真電話：(02)82094650

受文者：臺北市立中山女子高級中學

發文日期：中華民國113年12月30日

發文字號：龍華工字第1130013963號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：半導體研習課程簡章 (1131201549_1_半導體研習課程.pdf)

主旨：敬邀國內半導體科技相關系所及對半導體有興趣之教師，
報名參加本校113學年度國內教師「半導體技術」第一梯
研習課程，惠請週知所屬單位，請查照。

說明：

一、教育部補助辦理「半導體技術研習課程-半導體元件製程實作與產業局勢分析」，以提升教師實務專長。課程規劃4個課程單元，分別為「半導體產業局勢分析與環境永續趨勢」、「半導體元件製程實作」、「半導體封裝測試實作」與「企業參訪」。課程除了介紹半導體產業、技術外，亦加入未來不可忽略之地緣政治及ESG討論，可提升教師專業能力，進而提供學生更完善的學習資源及課程(研習課程簡章詳如附件)。

二、研習相關資訊：

(一)研習時間：114/1/4(六)、1/5(日)、1/11(六)、1/12(日)、1/18(六)、1/20(一)~1/24(五)共計10天，若全程出席將可獲得計10天，共70小時研習證書。

中山女高 1131230



MSAA1133014633



(二)研習地點：龍華科技大學(桃園市龜山區萬壽路一段300號)涵青館二樓及半導體系館半導體元件製造中心。

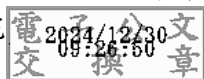
(三)研習人數：本梯次15人額滿為止(本校教師最多10位)。

三、報名方式：自即日起於114年1月3日中午12：00前至網址：
<https://reurl.cc/M6yK7v>完成報名(或直接掃描簡章上QR code直接進入表單報名)。

四、若有任何問題，歡迎聯絡半導體系張勤煜老師。聯絡電話：02-82093211#5217 E-mail：cyc@mail.lhu.edu.tw

正本：各公私立大專校院、全國高級中等學校

副本：本校工程學院



校長葛自祥

半導體研習課程

半導體元件製程實作與 產業局勢分析

課程時間/地點

第一梯次:

114/1/4(六)、1/5(日)、1/11(六)、1/12(日)、1/18(六)

1/20(一)~1/24(五) 共計10天

早上9:00~下午17:00

涵青館2樓以及半導體系館半導體元件製造中心

報名對象

技職校院專業科目
技術科目教師

專業及技術人員或
專業及技術教師

聯絡窗口:龍華科技大學半導體工程系.張勤煜老師

聯絡電話:02-82093211#5217

電子信箱:cyc@mail.lhu.edu.tw

開放報名時間:

即日起至114年1月3日中午12:00為止

報名網址:<https://reurl.cc/M6yK7v>



報名QRcode

龍華科技大學113學年度教師產業研習 半導體技術研習課程

課程簡介

本研習課程共規劃4個課程單元，分別為「半導體產業局勢分析與環境永續趨勢」、「半導體元件製程實作」、「半導體封裝測試實作」與「企業參訪」

希望透過此研習課程，讓參與研習教師，對於半導體技術，能有更全面，進一步地瞭解。

課程時間

第一梯次:

114/1/4(六)、1/5(日)、1/11(六)、1/12(日)、1/18(六)、
1/20(一)~1/24(五) 共計10天

研習地點

龍華科技大學(桃園市龜山區萬壽路一段300號)
涵青館2樓以及半導體系館半導體元件製造中心

研習人數

每梯次15位額滿為止(本校教師最多10位)

研習對象

若全程出席將可獲得計10天，共70小時研習證書
若有部分時間衝突，可與計劃主持人聯絡討論

報名時間

即日起至114年1月3日中午12:00為止

報名網址:<https://reurl.cc/M6yK7v>

聯絡資訊

計劃主持人:龍華科技大學半導體工程系.張勤煜老師

聯絡電話:02-82093211#5217 電子信箱:cyc@mail.lhu.edu.tw



報名QRcode

113學年度第一梯次-課程及時間表

日期/時間	課程議題
1/4 (六) 09:00-12:00	半導體產業局勢分析 (一)
1/4 (六) 13:00-17:00	半導體產業局勢分析 (二)
1/5 (日) 09:00-12:00	ESG環境永續趨勢 (一)
1/5 (日) 13:00-17:00	ESG環境永續趨勢 (二)
1/11 (六) 09:00-12:00	半導體元件製程介紹與實作 (一)
1/11 (六) 13:00-17:00	半導體元件製程介紹與實作 (二)
1/12 (日) 09:00-12:00	半導體元件製程介紹與實作 (三)
1/12 (日) 13:00-17:00	半導體元件製程介紹與實作 (四)
1/18 (六) 09:00-12:00	半導體元件製程介紹與實作 (五)
1/18 (六) 13:00-17:00	半導體元件製程介紹與實作 (六)

1/20 (一) 09:00-12:00	半導體封裝測試介紹與實作 (一)
1/20 (一) 13:00-17:00	半導體封裝測試介紹與實作 (二)
1/21 (二) 09:00-12:00	半導體封裝測試介紹與實作 (三)
1/21 (二) 13:00-17:00	半導體封裝測試介紹與實作 (四)
1/22 (三) 09:00-12:00	半導體封裝測試介紹與實作 (五)
1/22 (三) 13:00-17:00	半導體封裝測試介紹與實作 (六)
1/23 (四) 09:00-12:00	半導體封裝測試介紹與實作 (七)
1/23 (四) 13:00-17:00	半導體封裝測試介紹與實作 (八)
1/24 (五) 09:00-12:00	企業參訪
1/24 (五) 13:00-17:00	企業參訪